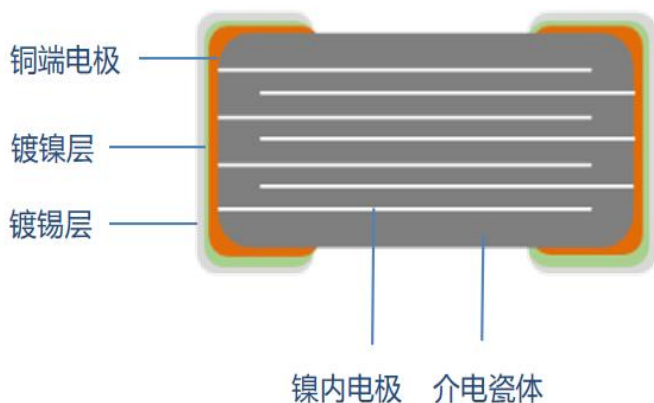


■ MLCC 用铜端电极浆料

◆ 特征

- * 红色膏状流体，主要由铜粉、玻璃粉和有机黏合剂组成。
- * 不含铅、镉、六价铬等禁用物质，符合 RoHS 指令环保要求。
- * 应用于 BME-MLCC，作端电极用。

◆ 产品在 MLCC 中应用示意图及产品图片



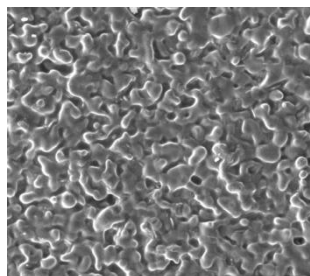
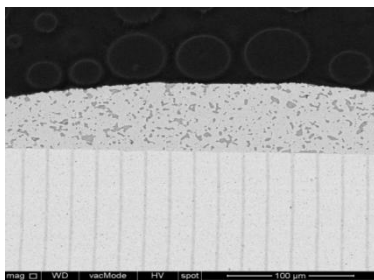
◆ 物理性能

型号	固含量 (%)	粘度* (Pa·S)	细度	适用性
CB06	82.5±1.5	20.0~30.0	≤8.0 μm	X7R 材料, 0201-1210 规格
CB75	80.5±1.0	26.0~32.0	≤8.0 μm	X7R、COG 材料, 0402-1812 规格
CN31	82.4±1.5	20.0~30.0	≤8.0 μm	COG 材料, 0402-0805 规格
CF63	79.8±1.0	25.0~31.0	≤8.0 μm	Y5V、X7R 材料, 0402-1812 规格

(注*: 粘度检测条件为 Brookfield HBDV-II +, CP52, 10rpm, 25±0.5℃)

◆ 产品特点

- * 烧结后端头铜层致密性好。
- * 导电率高。
- * 烧结后与瓷体结合紧密，附着力高。



◆ 推荐工艺

- * 搅 拌：使用前慢速搅拌均匀。
- * 封 端：用匹配的设备及技术参数进行封端。
- * 干 燥：链式烘炉（适量抽风），100~110℃(峰值温度)，25~30min（全程时间）。
因设备差异，客户可根据实际情况适当调试温度。
- * 烧 结：在保护气氛下烧结，根据瓷体体系选择具体的烧结温度。建议烧结温度如下：

型号	烧结峰值温度 (℃)	峰值时间 (min)
CB06	765±10	7.5~10
CB75	855±10	10~20
CN31	755±10	10~20
CF63	930±10	10~20

◆ 产品使用注意事项

- * 电 镀：适用于氨基磺酸体系的电镀液。
- * 清 洗：建议使用无水乙醇。
- * 储存条件：建议在温度 18~25℃、湿度≤75%环境密封储存，避免置于阳光直射或含有腐蚀性气体环境中。
- * 有 效 期：建议在符合上述储存条件下三个月内使用。
- * 包装规范：采用 PE 塑料瓶，500g/瓶或 1000g/瓶或 1500g/瓶。